

平成 30 年 8 月 10 日

一般社団法人 スマートプロセス学会  
エレクトロニクス生産科学部会  
電子デバイス実装研究委員会  
委員長 福本信次

## 第 23 回 電子デバイス実装研究委員会開催通知

第 23 回電子デバイス実装研究委員会（スマートプロセス学会）を下記の通り開催致します。今回は、シンポジウム MES の前日（9 月 5 日）に開催されることも有り、実装業界のますますの発展のためエレクトロニクス実装学会会員ならびにシンポジウム MES 参加の皆様にもご案内する機会をいただきました。これを機に両学会の交流が深まることを期待しております。なお、夜に懇親会も予定しております。参加ご希望の方は下記宛てに申込をお願いします。

定員に達し次第締め切らせていただきますことご了承下さい。出欠は 8 月 24 日（金）までにお知らせ下さい。

以 上

### 記

1. 日 時 平成 30 年 9 月 5 日(水) 10:30～16:25
  2. 場 所 大阪大学 大学院工学研究科（吹田キャンパス）  
R1 棟 3 階 312 岡田メモリアルホール  
キャンパスマップ <http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/campusmap.html>  
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1
  3. 参加費:10,000 円(エレクトロニクス実装学会 正会員, シンポジウム MES 参加者)  
(※スマートプロセス学会・電子デバイス実装研究委員会メンバーの方は通常通り無料です)
  4. 定員:100 名
  5. 申込先:エレクトロニクス生産科学部会 事務局(ものづくりリエゾンオフィス(MLO)内)  
E-mail: [mste@sps-mste.jp](mailto:mste@sps-mste.jp)  
TEL: 06-6878-5628
- 氏名:  
所属:  
電話:  
懇親会:(参加, 不参加)

## 第 23 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時：平成 30 年 9 月 5 日(水) 10:30～16:25

場所：大阪大学 吹田キャンパス 岡田メモリアルホール(工学部内 R1 棟3階 312)

時 間	題 目	講 演 者
	司会 井上雅博 (群馬大学)	
10:30～ 12:00	『“セルロースナノファイバー”の電子デバイス 応用』 (45 分)	○能木雅也 (大阪大学)
	『フレキシブル基板に低ダメージなデバイス 製造技術・実装技術の開発』 (45 分)	○植村 聖、金澤賢司、渡邊雄一、 中村考志、西岡将輝 (産業技術総合研 究所)
12:00～ 13:10	昼 食 休 憩	
13:10～ 13:20	委 員 会 議 事	
	司会 山中公博 (中京大学)	
13:20～ 14:50	『3D-MID対応の実装システムの開発』 (45 分)	○川北嘉洋、塚原法人、三宅貴大 (パナソニック(株))
	『金属塩の生成・分解反応を用いた電子 デバイスの低温接合に関する検討』 (45 分)	○小山真司 (群馬大学)
14:50～ 15:00	休 憩	
	司会 青島正貴 (トヨタ自動車(株))	
15:00～ 16:25	『車載用パワー半導体モジュールにおける 高信頼接合技術』 (45 分)	○両角 朗 (富士電機(株))
	『インフィニオン製車載用両面放熱パワー モジュール HybridPACK™DSC』 (40分)	○竹谷英一 (インフィニオンテクノロ ジーズジャパン(株))

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。